

Title (en)

Nickel based alloy for high temperature technology

Title (de)

Nickelbasislegierung für die Hochtemperaturtechnik

Title (fr)

Alliage à base de nickel pour des utilisations à haute température

Publication

**EP 1188845 A1 20020320 (DE)**

Application

**EP 01890180 A 20010608**

Priority

AT 15622000 A 20000914

Abstract (en)

Nickel-based alloy contains (in wt.%): 0.0015-0.60 carbon, 0.20-0.90 nitrogen, 22.0-32.0 chromium, 5.0-20.0 group 4, 5, or 6 elements except chromium, 0.03-3.0 aluminum, 0.4-3.0 silicon, up to 0.15 group 3 elements except actinides, up to 0.60 manganese, 14.8 iron, up to 0.01 boron, maximum 0.014 phosphorus, maximum 0.004 sulfur and minimum 51 nickel and/or chromium and unavoidable impurities.

Abstract (de)

Die Erfindung stellt eine kriechfeste korrosionsbeständige Nickelbasislegierung für eine Anwendung in der Hochtemperaturtechnik dar, bestehend aus in Gew.-% 0,0015: bis 0,60 Kohlenstoff ( C ); 0,20: bis 0,90 Stickstoff ( N ); 22,0: bis 32,0 Chrom ( Cr ); 5,0: bis 20,0 Elemente der Gruppe 4,5 und 6 des Periodensystems ausgenommen Cr; 0,03: bis 3,0 Aluminium ( Al ); 0,4: bis 3,0 Silizium ( Si ) bis 0,15 Elemente der Gruppe 3 des Periodensystems ausgenommen Actinoide bis 0,60 Mangan ( Mn ) bis 14,8 Eisen ( Fe ) bis 0,01 Bor ( B ) max 0,014 Phosphor ( P ) max 0,004 Schwefel ( S ) min 51 Nickel ( Ni ) und/oder Cobalt ( Co ) und erschmelzungsbedingte Verunreinigungen.

IPC 1-7

**C22C 19/05**

IPC 8 full level

**C22C 19/05** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C22C 19/053** (2013.01 - EP US); **C22C 19/055** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [YD] DE 4411228 A1 19951005 - KRUPP VDM GMBH [DE]
- [Y] EP 0322156 A1 19890628 - INCO ALLOYS INT [US]
- [A] EP 0251295 A2 19880107 - INCO ALLOYS INT [US]
- [A] GB 810366 A 19590311 - MOND NICKEL CO LTD
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1996, no. 04 30 April 1996 (1996-04-30)

Cited by

CN113555068A; US11193186B2; WO2019020145A1

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

**EP 1188845 A1 20020320**; **EP 1188845 B1 20050810**; AT 408665 B 20020225; AT A15622000 A 20010615; AT E301730 T1 20050815; CA 2355446 A1 20020314; CA 2355446 C 20111122; DE 50107021 D1 20050915; US 2002057984 A1 20020516; US 6797232 B2 20040928

DOCDB simple family (application)

**EP 01890180 A 20010608**; AT 01890180 T 20010608; AT 15622000 A 20000914; CA 2355446 A 20010817; DE 50107021 T 20010608; US 88006801 A 20010614